

2016年6月28日

報道関係者各位

DIC株式会社

〒103-8233 東京都中央区日本橋3-7-20

ディーアイシービル

DIC 高周波・高速基板などに使用可能な低誘電特性を実現する

エポキシ樹脂用特殊硬化剤を開発

大容量高速通信を支える画期的な新製品

DIC株式会社（本社：東京都中央区、社長執行役員：中西義之）は、大容量高速通信に必要な高周波・高速基板の絶縁材料などで使用可能な低誘電特性（誘電正接 1GHz：0.006）を実現するエポキシ樹脂用特殊硬化剤「EPICLON EXB-8100L-65T」を開発し、2016年1月よりサンプルワークを開始しました。同製品は、千葉工場などでの生産を予定しています。

近年、高周波・高速基板技術は、大量の情報を処理する通信インフラシステムや電子デバイスなどの高速通信化に寄与してきました。当社でもこのような技術を支える材料として各種高機能エポキシ樹脂、また、その硬化剤として低誘電特性を示す活性エステル型硬化剤「EPICLON HPC-8000-65T」（以下、HPC）を発売し、グローバル市場から高い評価を得ています。

このたび、当社ではよりハイエンドな基板向けの材料として、これまで当社が独自に蓄積したデータから有効な分子設計を見出し、極めて優れた低誘電特性を示す硬化剤を開発しました。本硬化剤を当社エポキシ樹脂と組み合わせて使用することで、誘電正接はHPC対比で約40%の低減を実現します。

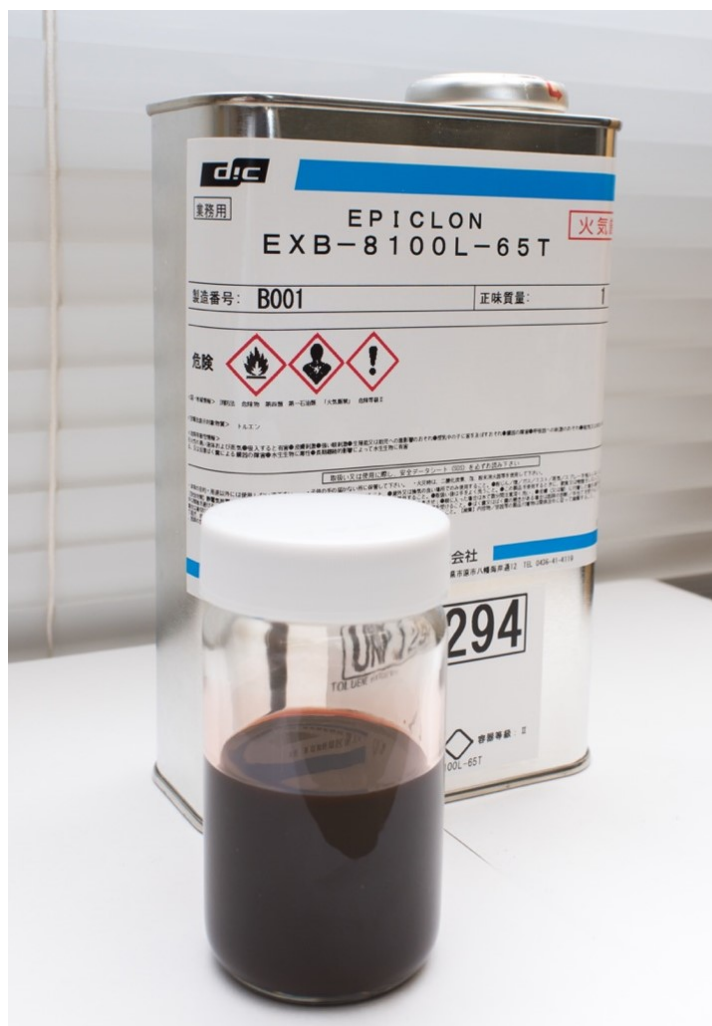
現在、ハイエンド基板には低誘電特性に優れるエンジニアリングプラスチックであるポリフェニレンエーテル（PPE）などが使われていますが、当社エポキシ樹脂と本硬化剤をご使用いただくことで、同等レベル以上の特性を発現することはもちろん、ユーザーでのコスト低減にも貢献します。また、エポキシ樹脂の特性である高い密着性を生かすことで、微細配線化が進む基板においても信頼性向上が期待できます。

エレクトロニクス市場向けを中心にエポキシ樹脂を展開し、国内トップシェアを誇る当社グループは、硬化剤においても、先に発表したDIC北日本ポリマ社の生産能力増強*の投資を行うなど、ハイエンド製品の供給体制を整えています。

アジアを中心とした新興地域において拡大する電子材料およびインフラ市場を確実に取り込むことで、2020年のエポキシ樹脂関連事業において売上高200億円を目指します。

※ DIC 北日本ポリマ株式会社のエポキシ樹脂特殊硬化剤の生産能力を増強
http://www.dic-global.com/ja/release/2016/20160517_01.html

以上



報道機関からのお問い合わせ
お客様からのお問い合わせ

コーポレートコミュニケーション部
ポリマ製品本部

TEL 03-6733-3033
TEL 03-6733-5881